



行业洞察 | 智能终端

AI重构体验 超级终端时代加速到来

文：高靖宇

“全

球智能终端行业站在了技术革新与生态重构的十字路口。AI技术的规模化渗透、折叠屏形态的成熟落地、跨设备协同的深度演进，正在重塑终端产品的价值逻辑与市场格局。

现状 | 重构中的终端产业新格局

2025年，智能终端行业呈现出“存量优化与增量突破并行”的发展特征。智能手机市场在调整中逐步复苏，端侧AI成为新品创新的核心引擎，折叠屏赛道则完成从小众尝鲜到规模化竞争的跨越，三大主线共同勾勒出行业发展的基本盘。

● 现状1：智能手机市场延续复苏态势

经历连续多年的市场调整后，全球智能手机行业在2025年迎来明确的复苏信号，这种复苏并非简单的量能回升，而是伴随结构优化的高质量增长。从全球市场来看，IDC公布数据显示，今年第三季度全球智能手机出货量同比增长2.6%，结束了此前的波动调整态势，复苏动力主要来自两方面：一是积压的换机需求逐步释放，二是头部厂商的AI创新与形态升级有效激活了消费意愿，AI手机、AIPC、AI眼镜等新形态设备加速落地，行业竞争从单一产品比拼，转向以全场景体验为核心的生态构建。

中国市场则呈现“调整企稳、结构升级”的特点。尽管2025年三季度中国大陆智能手机市场同比仍下降2%（来自Counterpoint Research市场数据），但跌幅已较上季度明显收窄，显示市场正逐步回归常态。值得注意的是，中国手机厂商的高端机型增长趋势愈发明显。数据显示，2025年1—7月，苹果在该价格区间的份额从23.4%下降至17%，而vivo则从8.8%升至14%。在剔除苹果后的国产品牌竞争中，华为、小米与vivo占据前三席，合计占比3/4以上，成功扭转了消费者的的品牌认知。

2025年第三季度，全球前五大智能手机厂商——出货量、市场份额、同比增幅					
厂商	2025年第三季度 出货量 (单位：百万台)	2025年第三季度 市场份额	2024年第三季度 出货量 (单位：百万台)	2024年第三季度 市场份额	同比增幅
1. Samsung	61.4	19.0%	57.7	18.4%	6.3%
2. Apple	58.6	18.2%	57.0	18.1%	2.9%
3. Xiaomi	43.5	13.5%	42.8	13.6%	1.8%
4. Transsion	29.2	9.0%	25.7	8.2%	13.6%
5. vivo	28.8	8.9%	27.0	8.6%	6.9%
其他	101.2	31.4%	104.5	33.2%	-3.2%
合计	322.7	100.0%	314.6	100.0%	2.6%

来源：IDC全球季度手机市场跟踪报告，2025年第三季度

注1：数据为初版，存在变化可能。数据均为四舍五入后取值。

注2：如果两家或两家以上厂商的营收份额或单位出货量相差0.1%或更少，IDC将宣布这些厂商在中国智能手机市场上排名并列。

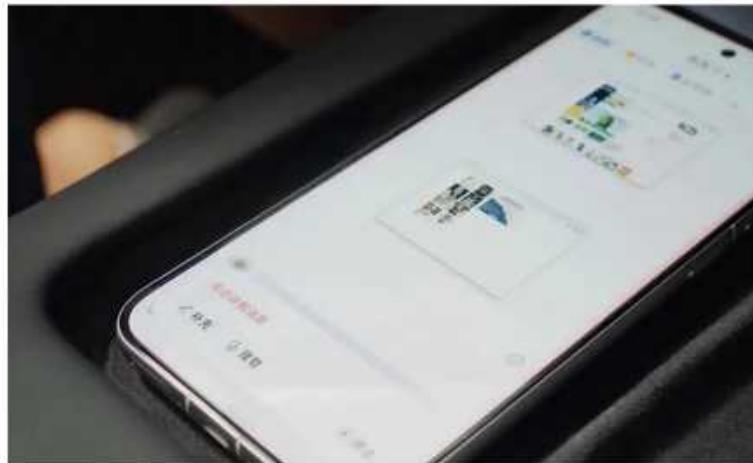
● 现状2：端侧AI新品落地提速，多品类形成矩阵化布局

2025年成为端侧AI终端规模化落地的元年，AI手机、AI PC、AI眼镜等新品密集亮相，技术从概念炒作走向场景落地，产品从单点突破走向矩阵化布局，端侧AI正重塑智能终端的产品形态与核心价值。

AI手机成为行业竞争的核心赛道，实现从“功能叠加”到“体验重构”的跨越。10月以来，苹果、vivo、OPPO、荣耀等主流厂商密集发布旗舰新机，都将AI视作重要标签。荣耀Magic8系列自称是“首款自进化AI

原生手机”，OPPO Find X9系列强调“端侧AI体验突破”。与此前“AI拍照”“AI优化”等点状功能不同，2025年的一个显著变化在于，AI开始向系统底层下沉，在办公、生活、出行、通信等场景做到服务一站直达、一问即用。比如，聚合高德、携程等多家主流旅行平台数据，可为用户生成一份完全贴合需求的旅行政略；也能根据用户喜好推荐商品。当AI不再只是被动响应，而是主动参与并完成行为路径，手机的角色正在发生改变。





AIPC成为办公场景的创新焦点，本地化大模型驱动效率革命。2025年，联想、华为等厂商推出的AI PC产品，通过搭载本地化运行的大模型，实现了文档处理、语音转译、多任务协同等核心办公场

景的效率提升。芯片层面，高通骁龙8 Elite等旗舰芯片的算力突破45TOPS，为AI PC的本地化算力需求提供了硬件支撑，使复杂AI任务的实时处理成为可能。



AI眼镜等可穿戴设备实现场景拓展，成为端侧AI的重要落地载体。2025年，AI眼镜产品在功能场景与交互体验上持续升级，形成了覆盖翻译、办公、出行、娱乐等多元场景的产品矩阵。IDC预测，2026年中国智能眼镜市场将持续高速发展，出货量预计达到450.8万台，同比增长77.7%。智能眼镜高速

增长的市场潜力吸引了众多企业争相布局，华为、Rokid、百度、雷鸟创新、星纪魅族等知名企业和品牌已相继推出了智能眼镜新品。“像手机一样，成为下一代超级终端”，智能眼镜具备的发展潜力，预示着一个新的行业风口正在到来。

● 现状3：折叠屏赛道进入规模化竞争阶段

2025年，折叠屏手机市场完成从小众尝鲜到主流主力机的关键跨越，技术成熟度提升、成本下降、场景价值释放三大因素共同推动赛道进入规模化竞争阶段。全

球与中国市场均呈现高速增长态势，头部厂商加速布局，产品形态持续创新，市场竞争从“技术验证”转向“体验优化与差异化竞争”。



市场规模实现突破性增长，渗透率持续提升。Counterpoint Research数据显示，2025年三季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长14%，创下季度历史新高；中国市场表现更为强劲，IDC数据显示，今年前三季度中国折叠屏手机市场累计出货量762万台，同比增长14.3%。预计2025年中国折叠屏手机市场出货量接近千万，延续增长趋势。这种增长态势背后，是折叠屏产品体验的全面成熟：此前制约普及的厚重感、结构可靠性等核心痛点已通过铰链技术升级、材料创新得到突破性解决，华为、荣耀等厂商的最新折叠屏产品在重量和厚度方面已接近传统直板旗舰机；续航技术、影像算法的优化则补

足了此前的体验短板，使折叠屏手机能够全面满足消费者日常使用需求。

产品形态创新成为差异化竞争的核心方向，从“单一折叠”向“多元形态”演进。华为曾推出Mate XT非凡大师，借助全新的“Z”字型三折叠，为行业展示了一种全新的形态可能；三星则通过全新发布的Galaxy Z TriFold，通过另一种“U”字型折叠方案，带来了另一种三折叠解法；荣耀Magic V5再度刷新折叠屏轻薄纪录，通过形态创新吸引追求便携性的消费者。这些创新标志着折叠屏市场已从“同质化竞争”转向“技术迭代+形态创新”的双轮驱动格局。

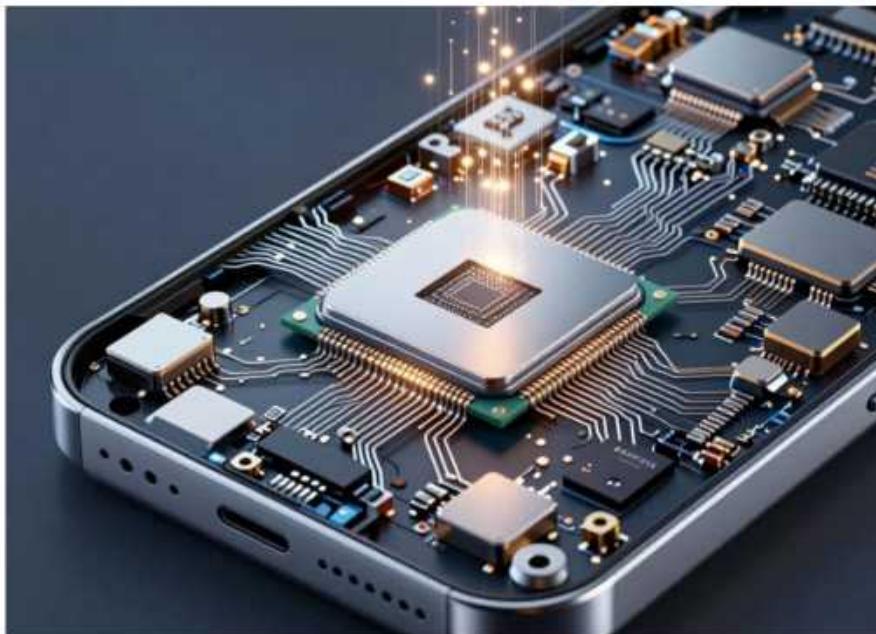
挑战 | 高速发展背后的行业桎梏

在智能终端行业高速发展的同时，技术瓶颈、生态割裂、成本压力三大核心挑战也日益凸显。这些问题不仅制约着行业的进一步增长，也考验着产业链各方的协同创新能力，成为2025年行业发展必须突破的桎梏。

● 挑战1：技术瓶颈凸显，算力与能效的平衡难题

端侧AI的规模化落地对终端算力提出了前所未有的需求，但算力提升与能效控制之间的矛盾成为行业普遍面临的技术瓶颈。当前，AI终端的核心算力需求主要来自端侧大模型的运行，无论是AI手机的实时翻译、图像编辑，还是AI PC的文档处理、多任务协同，都需要强大的本地算力

支撑。为满足这一需求，芯片厂商不断提升芯片算力，高通骁龙8 Elite芯片算力已突破45TOPS，华为麒麟旗舰芯片的AI算力也达到相近水平，但算力的提升直接导致芯片功耗增加，进而影响终端设备的续航表现。



具体来看，当前主流AI手机在开启连续AI任务时，往往有大量的数据进入到芯片中，而处理这些海量数据需要消耗更多电能、增加功耗。部分高端机型为平衡算力与续航，不得不采用更大容量的电池，这又与消费者对设备轻薄化的需求产生冲

突。除了芯片层面的矛盾，端侧大模型的优化也面临挑战：轻量化模型虽能降低算力需求，但会牺牲部分功能精度；而高精度模型则需要更大的存储空间与更强的算力支持，难以在中端机型上普及。

折叠屏领域同样存在技术瓶颈，尽管铰链技术与柔性屏技术已取得显著进步，但折痕控制、长期耐用性、低温环境适应性等问题仍未完全解决。有用户反映，使用半年后折痕处的屏幕灵敏度明显下降，

铰链出现异响、松动的情况，严重影响操作体验。此外，折叠屏手机的维修成本居高不下，屏幕与铰链的维修费用通常占整机价格的40%—50%，这也制约了其进一步普及。

● 挑战2：生态碎片化严重，标准与协同机制缺失

随着智能终端品类的不断丰富，跨设备协同成为用户核心需求，但当前行业内生态碎片化严重，缺乏统一的标准与协同

机制，导致用户体验割裂，制约了全场景智能生态的构建。



操作系统层面，当前智能终端市场形成了iOS、Android、HarmonyOS等多系统并存的格局，不同系统之间的壁垒难以打破。尽管HarmonyOS提出“一次开发、多端部署”的理念，实现了跨设备的无缝协同，但仅覆盖华为及合作厂商的设备；iOS生态则保持相对封闭，与其他系统的互联互通仅限于基础的文件传输，无法实现深度的功能协同。例如，用户在

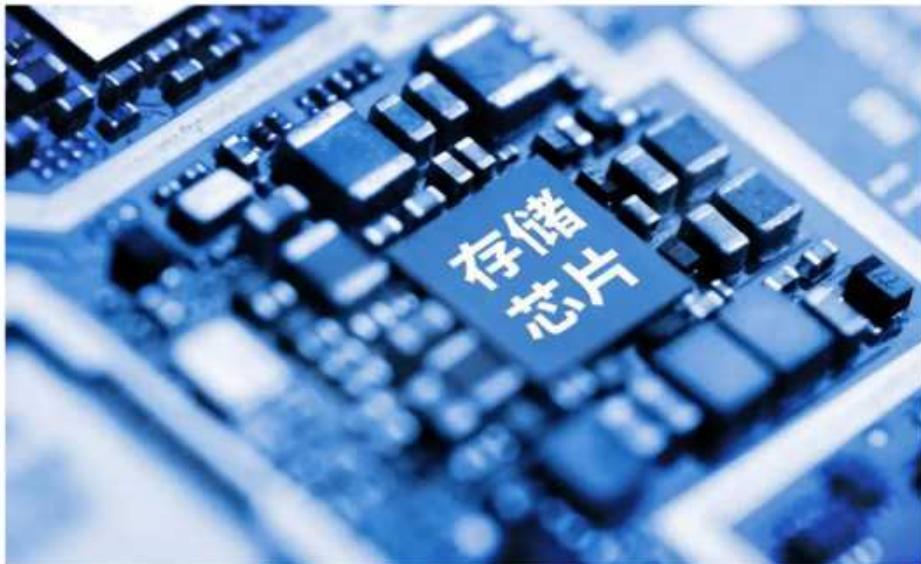
Android手机上编辑的文档，难以在iOS平板上无缝接续编辑，这种系统壁垒严重影响了用户的全场景体验。

生态碎片化的根源在于行业内缺乏统一的标准制定与协同机制。当前，各主流厂商都在构建自己的封闭生态，以提升用户粘性与市场竞争力，这种“各自为战”的格局导致行业资源分散，难以形成合力。

● 挑战3：存储芯片涨价，终端成本全面承压

2025年下半年以来，DDR5、DDR4 等主流存储芯片价格单月涨幅突破100%，三星、SK 海力士等原厂暂停报价，

这场罕见的行业普涨正以前所未有的速度向下游传导，终端厂商已感受到来自成本上涨的阵阵“寒意”。



这场涨价潮的根源，是存储芯片涨价背后是AI带来的“吞噬式需求”正在重塑存储行业，AI服务器的旺盛需求让原本稳定的供需平衡被打破。与普通服务器相比，每台AI服务器的DRAM（主要用于电脑内存，如DDR，以及手机内存，如LPDDR）需求和NAND需求是普通服务器的8倍和3倍。

上游的剧烈波动，正迅速传导至下游终端，手机市场成为首批承压的领域。存储芯片占手机硬件成本的10%—20%，高配旗舰机型占比更是超过30%，原厂近50% 的涨幅报价，让手机厂商陷入两难境地。机构普遍预测，这场存储涨价潮并非短期波动，至少将延续至2026年上半年，甚至有存储企业高管判断，DDR5 和 DDR4 的缺货潮可能持续到2027年。

趋势 | 智能终端的未来演进方向

面对发展中的挑战，2025年智能终端行业的演进方向逐渐清晰。AI智能体的标配化将推动终端智能化进入主动服务阶段，生态协同的开放化将打破设备壁垒构建超级终端体验，技术创新的用户导向化将实现从参数竞赛到体验优化的回归，三大趋势将共同定义未来智能终端的发展蓝图。

● 趋势1：AI智能体成为标配，终端智能化进入“主动服务”新阶段

随着端侧AI技术的成熟与大模型的轻量化迭代，AI智能体将逐步成为智能终端的标配，推动终端智能化从“被动响应”向“主动服务”转型，重塑用户与终端的交互关系。与云端大模型调用相比，AI智能体具备更强的场景感知、意图理解与主动决策能力，能够基于用户习惯与场景需求提供个性化、精准化、即时响应的服务。

AI智能体的核心优势在于“主动预判与精准服务”。例如vivo的蓝心个人智能，可理解用户习惯差异，比如游戏玩家启动《王者荣耀》时自动调度性能，办公用户切换文档时优化续航；荣耀的YOYO智能体凭借“看见、记忆、执行”三大能力，可完成AI

追色修图、自由指令生图等复杂任务；“零重力通透设计”依托行业首创的通透引擎，实现全局视觉通透感且不增加功耗。此外，AI通话反诈功能还能智能识别假声、诈骗话术，保障用户财产安全。

从产品布局来看，AI智能体正从高端机型向中低端机型渗透，成为全价位段产品的核心竞争力。2025年，华为、vivo、OPPO、荣耀等主流厂商均在其全系列手机中搭载自研AI智能体。IDC预计，2026年国内新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%，AI智能体将成为消费者选购终端的核心考量因素之一。

● 趋势2：生态协同走向开放，跨设备融合构建“超级终端”体验

面对生态碎片化的挑战，开放协同成为行业共识，2025年智能终端行业将迎来生态开放的浪潮。主流厂商逐步打破封闭生态的壁垒，通过技术开源、标准共建、合作共赢

的方式，推动跨品牌、跨系统、跨设备的深度融合，构建“超级终端”体验，实现硬件能力共享、任务无缝流转、服务随心切换。



操作系统的开放化演进是生态协同的核心驱动力。HarmonyOS持续推进开源战略，截至2025年，开源鸿蒙代码量超过1.3亿行，开发者数量超800万，生态设备突破11.9亿台，95%常用APP完成适配。华为通过DevEco Studio开发工具，实现“一次开发、多端部署”，开发者不用再为手机、平板、车机分别写代码，降低了适配成本。更重要的是，鸿蒙2025实现了与iOS生态设备的近场互传，无需流量即可完成跨系统文件交换，打破了此前的系统壁垒。

硬件连接技术的标准化与普及将加速跨设备融合。星闪技术作为我国自主研发的近场通信技术，凭借高速率、低延迟、低功耗的优势，正逐步成为跨设备连接的重要标准。2025年，星闪技术已在华为、荣耀、小

米等厂商的终端产品中广泛应用，搭配鸿蒙的星河互联架构，跨设备交互时延压缩至8毫秒，传输速率达到160MB/s，1GB 4K视频6秒即可传完，支持60+应用跨端接续。随着连接技术的标准化，跨品牌设备的协同成功率将大幅提升，预计2026年将达到85%以上。

“超级终端”体验将成为生态协同的最终呈现形式。用户可通过“碰一碰”或拖拽的方式，将手机、PC、智慧屏、智能手表等设备连接成一个“超级终端”，实现硬件能力的共享与任务的无缝流转。例如，荣耀的“跨智能体互联”，能实现与iOS、鸿蒙、安卓、Windows等主流系统深度互联，用户可轻松跨品牌传输文件、同步服务。

● 趋势3：技术创新聚焦“用户体验”，从参数竞赛回归价值本质

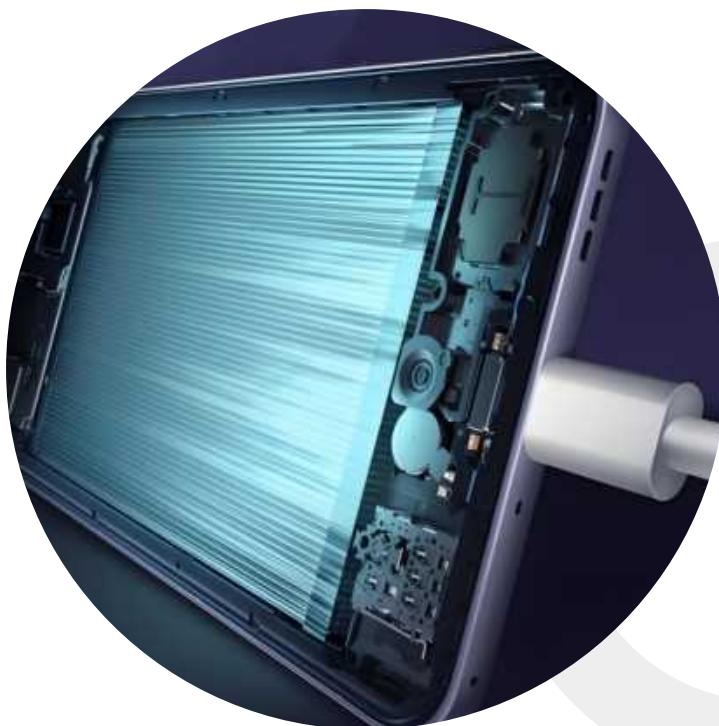
经历多年的参数竞赛后，2025年智能终端行业的技术创新将全面回归用户体验本质，厂商不再单纯追求硬件参数的堆砌，而是通过技术优化解决用户的核心痛点，提升

产品的实际使用价值。这种转变体现在产品设计、续航优化等层面，推动行业从“技术驱动”向“需求驱动”转型。



产品设计层面，轻薄化、便携化、人性化成为核心方向。10月13日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商同步官宣，正式获批开展 eSIM 手机运营服务商商用试验，标志着我国移动通信市场迎来了“无卡时代”的关键转折点。当手机告别实体 SIM 卡的束缚，终端制造领域首先迎来了前所未有的设计自由度。以全球首款仅支持eSIM的智能手机iPhone Air 为例，去除卡槽后，机身内部空间得以释放，苹果得以将更多的精力投入到电池容量提

升、散热系统优化以及机身厚度的极致压缩上，实现了 5.6mm 的超薄机身设计，为消费者带来了全新的视觉和握持体验。对于其他手机厂商而言，eSIM 技术同样为他们在产品创新上提供了广阔的空间，未来，我们或许将看到更多形态各异、功能更加强大的智能手机问世，如可折叠手机将能进一步优化内部结构，提升折叠态下的使用体验；而对于追求极致轻薄的手机产品，eSIM 技术更是成为实现这一目标的关键因素。



续航优化层面，AI应用的全面渗透正重塑智能终端的使用体验，却也带来了功耗激增的核心挑战。为了对冲AI带来的续航压力，电池容量升级成为2025年手机行业的核心竞争赛道，手机电池容量已普遍向8000mAh迈进，而这只是续航升级的起点。年末，荣耀官方确认，即将于12月26日发布的荣耀WIN系列将全系搭载10000mAh巨无霸青海湖电池，采用新一代

更高能量密度的硅碳负极技术，电池硅含量进一步提升。除了荣耀WIN系列外，定位中端市场的Power系列、X系列乃至畅玩系列，都将推出典型容量超过10000mAh的机型。在其带动下，万级电池有望成为2026年旗舰机的新标配，而行业竞争焦点也将从单纯的容量比拼，转向电池材料创新、能效优化与散热的协同升级，对手机结构设计提出了更高要求。

结语

“ 2025年，智能终端行业在复苏与挑战中迎来深刻变革。智能手机市场的结构优化、端侧AI终端的规模化落地、折叠屏赛道的竞争升级，共同构成了行业发展的基本盘，显示出强大的发展韧性。展望未来，AI智能体的标配化、生态协同的开放化、技术创新的用户导向化，将成为引领行业发展的三大核心趋势。这三大趋势的演进，将推动智能终端行业从存量竞争走向增量创新，从硬件比拼走向生态共建，从技术驱动走向价值引领，为我们的科技生活描绘出一幅更加美好的画卷。

”